

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

2024 年年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）持续督导工作的保荐人，负责公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与晶合集成签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024 年度晶合集成在持续督导期间未发生按有关规定需保荐人公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024 年度晶合集成在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解晶合集成业务情况，对晶合集成开展了持续督导工作。

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2024 年度，保荐人督导晶合集成及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促晶合集成依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对晶合集成的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，晶合集成的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促晶合集成依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐人对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024 年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024 年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024 年度持续督导期间内，经保荐人核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024 年度持续督导期间内，晶合集成未发生左述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，明确了现场检查工作要求，并确保了现场检查工作质量。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，晶合集成不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1.研发人员不足或流失风险

公司自成立以来一直从事集成电路晶圆代工业务，所处行业为资本、技术、管理和人才密集型的综合性行业，稳定、专业的研发团队是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。随着集成电路企业数量的不断增长，行业竞争不断加剧，企业之间人才的争夺也更加激烈。公司高度重视人才队伍建设，采取股权激励等多种措施吸引、留住优秀技术人员，已发展和培养了一支成

熟、稳定、创新能力强的核心研发团队，为公司新产品、新制程的研发和生产做出了突出贡献。虽然正常的人才流动不会对公司的研发和经营造成重大不利影响，且公司与主要技术人员签署了竞业禁止协议，但如果主要技术人员大量流失，则可能对公司的研发生产造成较大不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。

2.产品开发风险

集成电路晶圆代工业务涉及多种学科技术的复合，技术复杂程度高，需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，新技术从研发至产业化的过程具有资金投入大、研发周期长、结果不确定性高等特点。同时，集成电路丰富的终端应用场景决定了各细分领域芯片产品的主流技术节点与工艺存在差异，相应市场需求变化较快，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司未来无法对新的市场需求、技术趋势做出及时反应，在产品开发方向的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，导致新产品无法顺利通过客户的产品导入和认证，将对公司的市场竞争力造成不利影响。

3.核心技术外泄或失密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司储备了一系列具有自主知识产权的核心技术，拥有覆盖研发及生产过程中的各个关键环节的数百项专利，同时，公司仍在持续进行多项针对主营业务的技术研发工作。公司十分重视对核心技术的保护工作，通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护，并制定了保密制度，对核心技术人员在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况作出了严格规定，同时，通过对访问权限划分、敏感信息监控等方式加强网络安全管理，以保护公司的合法权益，防止核心技术外泄。但由于技术秘密保护措施的限制及其他不可控因素，在人员流动、上下游业务交流的过程中，公司的技术和研发成果仍面临一定的泄密风险，从而对公司核心竞争力产生风险。

（二）经营风险

1.客户集中度较高的风险

2024 年度（以下简称“报告期”或“本期”），公司前五大客户的销售收入合计 567,067.87 万元，占营业收入的比例为 61.32%，客户集中度较高。公司凭借自身的

研发能力、产品品质、产能支持、客户服务等综合能力，与主要客户保持了良好的合作关系并与部分客户签署了长期合作的框架协议。但未来若公司的主要客户因产品布局优化、技术路径转变、增加新供应商或更换供应商、下游需求变化等情况，或者公司新产品研发、生产经营无法满足客户需求，导致主要客户向公司下达的订单数量大幅下降，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

2.新产品需求不及预期风险

公司一直重视新产品、新制程和特色工艺平台的研发工作，目前 55nm 中高阶单芯片及堆栈式 CIS 芯片工艺平台已大批量生产，40nm 高压 OLED 芯片工艺平台已实现量产，55nm 车载显示驱动芯片量产、28nm 逻辑芯片通过功能性验证。新产品的陆续研发完成并通过认证及量产，将会给公司经营业绩带来新的增长点。但新产品能否快速导入及放量取决于市场发展趋势、客户需求、公司的客户拓展能力等多种因素，公司存在新产品需求不及预期的风险。

3.公司产品结构相对集中的风险

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务，目前的主要产品包括 DDIC、CIS、PMIC、MCU 和 Logic，虽然报告期内公司主营业务收入主要来自于 DDIC，该产品营收占比约为 67.50%，但是较 2023 年营收占比（84.79%）下降 17.29 个百分点，CIS 产品的营收占比较 2023 年提升 11.23 个百分点，产品结构有所改善。虽然公司正在进行 PMIC、MCU 和 Logic 等其他技术平台的研发和持续优化工作，并积极开拓市场，但在短期内，如果面板显示驱动芯片市场和图像传感器市场需求发生较大波动，导致公司在该领域的生产或销售出现不利变化，则可能对公司的盈利能力、经营性现金流产生不利影响。

4.公司无法及时消化新增产能的风险

报告期内，为提升公司满足市场需求的能力，后续公司将根据市场环境、客户需求、公司发展战略进一步进行弹性产能扩充。针对产能扩充，公司已进行了充分的市场调研和可行性分析，并在技术工艺、市场开拓、人员储备等方面做好了一系列准备工作。但未来若宏观经济环境、国家产业政策、技术发展方向发生重大变化，导致下游市场增速不及预期、公司核心客户需求改变，或其他同行业参与者纷纷加

速扩产导致供需市场变化等情形，公司将面临产能释放节奏和市场需求节奏不匹配致使无法及时消化新增产能的风险，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1. 固定资产投资的风险

公司所处的集成电路行业是典型的资本密集型行业，固定资产投资规模较大。为把握市场机遇、提升客户服务能力及强化市场地位，公司持续推进产能扩张战略。尽管已制定审慎的资本开支计划并配套多元化融资方案，但在产能实际建置过程中，受制于宏观经济波动、货币政策调整及资本市场融资环境变化等不可控因素，公司可能面临一定的资金压力。与此同时，随着大额固定资产的增加，折旧费用也将相应上升，但经济效益提升需要一定的时间，若公司未来产销规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，可能会对公司的盈利水平产生阶段性压力。

2. 存货跌价风险

报告期末，公司的存货账面价值为 150,332.06 万元，占总资产比例为 2.98%；存货跌价准备金额为 3,989.96 万元，对应存货期末余额的计提比例为 2.59%，较 2023 年末存货跌价准备对应存货期末余额计提比例 6.38% 已有所下降。公司生产安排主要以销售订单为基础，同时考虑客户中期需求情况制定排产计划，进行一定程度的备货，保证销售与生产的匹配与衔接。若未来市场环境发生变化、客户临时改变需求、竞争加剧或技术更新，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，将导致产品滞销、存货积压，公司将面临存货跌价的风险。

3. 毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率为 25.50%。公司的产品规格数量较多，不同制程和品类的产品单价及毛利率存在一定差异，产品结构的变化将影响公司的毛利率。其次，公司成本结构中以固定性成本为主，主要包含厂房、设备折旧等，价格和稼动率对毛利率影响较大。未来，如果市场供求关系、公司议价能力、技术发展趋势等发生重大不利变化，导致公司营业收入规模出现显著波动，或流失高毛利率业务，或新增设备稼动率较低，公司将面临毛利率波动的风险。

4. 外币汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算，公司相应持有美元、日元等外币货币性资产。虽然公司在业务开展时已考虑了订单签订及款项收付期间汇率可能产生的波动，也持续平衡外币货币性资产规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司有可能面临汇兑损失的风险。与此同时，如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格也将受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

（四）行业风险

1. 产业政策变化风险

作为国家重点鼓励发展的领域之一，集成电路行业近年来受益于多项产业政策的积极引导。国家陆续出台了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）等文件，系统性构建行业扶持框架；与此同时，各级地方政府通过税收优惠、融资支持、政府补贴、人才引进配套及知识产权保护等政策，为产业链内的企业营造了良好的发展环境。在政策驱动下，国内集成电路行业在设计研发能力、生产工艺升级及核心技术自主化等方面取得显著进步。如未来产业政策发生调整（如财税优惠退坡、补贴力度减弱或行业准入规则变化等），可能对公司技术研发、高端人才储备、产能扩张节奏及市场竞争力产生潜在不利影响。

2. 行业竞争加剧的风险

近年来，集成电路行业在国家政策引导及地方产业配套支持下已形成高速增长态势，良好的行业前景吸引了更多的新进入者和资金资源。伴随产业链产能规模化释放，市场供给不断增加，行业竞争格局呈现持续强化趋势。尽管公司通过自主研发工艺迭代升级及新产品开发实践，已构建较为完整的技术储备与量产经验体系，但在核心技术壁垒构建、高端市场渗透能力等方面仍与行业龙头企业存在一定差距。未来，若公司未能有效提升工艺技术前瞻性布局、加速产品矩阵创新升级，或对客户定制化需求响应效率不足，可能导致公司产品被竞品替代，从而导致公司在市场竞争中处于不利地位。

3.供应链风险

集成电路行业对核心原材料、精密零部件、专用软件及高端设备的品质与适配性具有严苛标准，部分重要原材料、零部件、专用软件、核心设备等的全球合格供应商数量较少，且主要分布于境外市场。尽管公司持续强化供应链安全体系建设，着力推进关键设备及材料国产化替代，但若国际贸易环境因地缘政治等因素发生重大变化，公司重要原材料、零备件、软件、设备等的出口许可、供应、物流受到限制或价格上涨，将对公司产能规划实施效率及技术迭代进度产生潜在制约。

（五）宏观环境风险

1.国际贸易摩擦加剧的风险

国际经贸关系随着国家之间政治关系的发展和国际局势的变化而不断变化，经贸关系的变化会对宏观经济的发展以及特定行业景气度产生深远影响。近年来，国际贸易摩擦不断，集成电路产业成为贸易冲突的重点领域，部分国家采用贸易保护、技术限制等非市场化干预措施，客观上制约我国产业链生态的协同发展进程。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦贸易政策、关税、出口限制、其他贸易壁垒进一步恶化，或导致公司业务受限、采购范围受限，将会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2.宏观经济波动和行业周期性风险

全球半导体市场在经历 2023 年库存调整后，2024 年进入复苏周期，但仍处于周期性波动中。公司主要从事集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售，属于集成电路行业的中游环节，具有较强的周期性，并且与下游行业及宏观经济周期密切相关。若未来宏观经济形势发生重大变化影响到下游行业的发展环境，将压制终端需求复苏，此外，下游厂商在刚经历行业周期性波动的低谷后备货策略趋谨慎，渠道去库存若不及预期将延缓价格反弹，包括公司在内的集成电路企业将面临一定的行业波动风险，对经营情况造成不利影响。

四、重大违规事项

2024 年度持续督导期间内，晶合集成不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年，晶合集成主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

项目	2024年度/2024年末	2023年度/2023年末	本期比上年同期增减(%)
营业收入	924,925.23	724,354.14	27.69
归属于上市公司股东的净利润	53,284.06	21,162.91	151.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,436.68	4,712.95	736.77
经营活动产生的现金流量净额	276,113.13	-16,103.60	不适用
归属于上市公司股东的净资产	2,087,031.10	2,140,980.47	-2.52
总资产	5,039,857.94	4,815,627.96	4.66

2024 年，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.12	125
稀释每股收益（元 / 股）	0.27	0.12	125
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2	0.03	566.67
加权平均净资产收益率（%）	2.52	1.09	增加1.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.86	0.24	增加1.62个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	13.88	14.6	减少0.72个百分点

2024 年度，晶合集成上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

营业收入较上年同期增加 200,571.10 万元，同比增长 27.69%，主要系报告期内半导体行业景气度持续向好，公司销量增加，收入规模持续增长所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 32,121.15 万元，同比增长 151.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 34,723.73 万元，同比增长 736.77%，主要系报告期内公司营业收入同比增长，同时公司整体产能利用率维持高位水平，单位销货成本下降，产品毛利率提升所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 292,216.72 万元，主要系本报告期营业收入同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.27 元/股、0.27 元/股、0.20 元/股，较上年同期分别增加 0.15 元/股、0.15 元/股、0.17 元/股，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发团队经验丰富，技术实力行业领先

公司研发团队核心成员均由境内外资深专家组成，在不同的技术方向具有丰富的研发经验，对行业发展现状和趋势有着深刻的认识和理解。公司已建立完善、成熟的研发机制，高度重视并持续加强研发团队建设及研发能力提升。公司坚持以行业发展趋势和客户需求为导向，积极探索新的业务领域，及时进行产品迭代，满足终端客户的需求。通过多年持续的研发投入，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，截至 2024 年末，公司共取得专利 1,003 个，其中发明专利 779 个、实用新型专利 224 个。

报告期内，公司研发投入金额达 128,397.52 万元，较上年增长 21.41%。截至 2024 年末，公司拥有员工 5,348 名，其中研发人员 1,866 名，占员工总数比例为 34.89%，研发人员中硕士及以上占比约 65.22%。

（二）产品结构不断丰富，工艺平台多元发展

公司已实现 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic 等工艺平台量产，产品结构日益多样化，产品应用涵盖智能手机、电脑、平板显示、汽车电子、智能家用电器、工业控制、物联网等诸多领域。报告期内，公司不断推出有市场竞争力的新产品，进一步优化了产品结构。40nm 高压 OLED 显示驱动芯片小批量生产；55nm 中高阶 BSI 及堆栈式 CIS 芯片实现大批量生产，CIS 产品已进入中高阶手机市场；55nm 车载显示驱动芯片已量产。

（三）位居合肥战略核心，产业链协同效应强

公司地处国家级科技创新型试点城市合肥市。合肥市基于“芯屏汽合”的产业

发展战略，已形成新型显示器件、集成电路、新能源汽车和人工智能等新兴产业。集成电路产业也是合肥市重点发展的战略性新兴产业，目前已集聚产业链上下游重点企业 450 多家，构建了从设计、制造、封装测试、装备材料，到公共服务平台的完整产业链生态。公司所处的代工环节为半导体产业链中最为重要的环节之一。公司充分发挥本地终端市场距离近、规模大的优势，依靠成熟制程制造经验，服务于合肥产业链规划，提供关键芯片，促进产业链协同联动发展，打造稳定、共赢的生态圈。

（四）客户关系紧密稳固，推动国产供应替代

公司对客户的核心需求、产品变动趋势、最新技术要求理解深刻，依靠稳定的交付能力、卓越的品质和优秀的服务获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可，与众多客户建立了长期、紧密、稳固的合作。公司客户群体覆盖部分国际一线公司。公司通过与战略客户的紧密协作，研发生产更贴近客户需要、符合市场需求的产品。同时公司在业界具有良好的口碑及供应商基础，最大程度地采用国产化设备与材料，保证供应链安全，推动国产供应替代。

（五）体系认证齐全，质量稳定可靠

公司建立了完善的质量管理体系，依托产品研发及工艺技术的综合实力保证并提升产品品质。截至目前，公司已取得质量管理体系认证 ISO9001、环境管理体系认证 ISO14001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001、有害物质过程管理体系 QC080000、温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认证。此外，在车用芯片领域，公司已取得车载质量管理体系 IATF16949 认证。

（六）智能制造，高效稳定，成本具有竞争力

公司智能生产线拥有高端智能制造营运管理制度及系统，涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的产品品质。公司成功将人工智能技术全面导入研发、营运等环节，实现 AI 智造升级及全局优化。同时公司积极推动关键原辅材料和设备的国产化。公司生产集中在同一园区内，本地产业链配套较为齐全，从原材料到整机产业链，可实现就近供应，且最大程度地采用国产化设备与材料，产品成本更具竞争力。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	128,397.52	105,751.18	21.41
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	128,397.52	105,751.18	21.41
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.88	14.60	减少 0.72 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

1、新一代 110nm 加强型微控制器平台(110nm 嵌入式 flash)完成开发并同步导入产品量产；

2、55nm 中高阶 BSI 及堆栈式 CIS 芯片工艺平台实现大批量生产；

3、40nm 高压 OLED 显示驱动芯片实现小批量生产；

4、28nm 逻辑芯片通过功能性验证，成功点亮电视面板；

5、110nm Micro OLED 芯片已成功点亮面板；

6、55nm 车载显示驱动芯片已量产。

报告期内，公司新增发明专利共 249 项，实用新型专利 76 项，软件著作权 1 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，晶合集成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行

价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税）	2,431,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额	101,875,967.20
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	7,837,988,550.61
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	4,933,604,786.90
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	829,159,209.30
减：节余资金永久补充流动资金	344,437,420.65
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	164,520,697.56
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金	750,000,000.00
截至2024年12月31日募集资金专户应有余额(d)	670,877,245.28
截至2024年12月31日募集资金专户实际余额(e)	670,349,083.66
差异(d-e) ^{注1}	528,161.62

注 1：差异原因见本节之“（二）募集资金合规情况”。

公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 20 亿

元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,412,025,172.64 元，其中 662,025,172.64 元为协定存款，750,000,000.00 元为券商收益凭证。报告期购买的券商收益凭证明细如下：

单位：人民币亿元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否赎回
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制 418 期固定收益凭证	保本固定收益	0.50	2023/7/13	2024/4/15	是
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制 417 期固定收益凭证	保本固定收益	2.00	2023/7/13	2024/5/13	是
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享 755 号收益凭证	保本固定收益	3.00	2023/7/17	2024/5/7	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金蟾 78 号浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2023/7/18	2024/4/17	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 92 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2023/7/18	2024/2/19	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利 40 期浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2023/7/18	2024/1/16	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利 42 期浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2023/7/18	2024/1/16	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利 41 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2023/7/18	2024/5/20	是
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 20 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2023/9/1	2024/3/4	是
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 21 期浮动收益凭证	保本浮动收益	2.00	2023/9/1	2024/3/4	是
中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动 65 号收益凭证	保本浮动收益	2.00	2023/9/4	2024/3/4	是
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列 136 期收益凭证（本金保障型收益凭证）	保本固定收益	2.00	2023/10/13	2024/1/11	是
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列 135 期收益凭证（本金保障型收益凭证）	保本固定收益	4.00	2023/10/13	2024/1/11	是
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制 500 期固定收益凭证	保本固定收益	1.00	2023/12/1	2024/3/4	是
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享 824 号收益凭证	保本固定收益	2.00	2024/3/7	2024/6/11	是

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否赎回
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制 538 期固定收益凭证	保本固定收益	1.00	2024/4/2	2024/6/12	是
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 55 期浮动收益凭证	保本浮动收益	3.00	2024/4/2	2024/6/12	是
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制 539 期固定收益凭证	保本固定收益	0.50	2024/4/16	2024/6/12	是
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享 837 号收益凭证	保本固定收益	3.00	2024/5/10	2024/6/12	是
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制 545 期固定收益凭证	保本固定收益	2.00	2024/5/14	2024/6/13	是
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富安享 859 号收益凭证	保本固定收益	1.00	2024/7/10	2024/10/15	是
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 81 期浮动收益凭证	保本浮动收益	2.00	2024/7/10	2025/1/6	否
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 82 期浮动收益凭证	保本浮动收益	2.00	2024/7/10	2025/1/6	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈 36 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2024/7/25	2024/10/28	是
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈 37 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2024/7/31	2025/2/5	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈 38 期浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2024/8/7	2025/2/11	否
中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动 195 号收益凭证	保本浮动收益	0.50	2024/10/18	2025/1/20	否
中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动 196 号收益凭证	保本浮动收益	0.50	2024/10/18	2025/4/21	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈 62 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2024/10/31	2025/5/6	否

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”予以结项，并将节余募集资金 34,214.87 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中金公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将全部节余募集资金 344,436,563.93 元（含扣

除手续费后的利息收入及理财收益）从募集资金存放专项账户转出，用于永久补充流动资金。公司在中国工商银行合肥四牌楼支行开立的账号为1302010129200389609的募集资金专户已办理销户手续，在中国建设银行合肥龙门支行开立的账号为34050144770800002618的募集资金专户由于涉及“收购制造基地厂房及厂务设施”项目外其他募集资金存储，仍将继续保留用于其余募集资金存储及使用。

募投项目“补充流动资金及偿还贷款”的募集资金已按规定用途使用完毕，截至本报告期末，公司已累计投入募集资金1,517,274,213.08元至该募投项目，该募投项目自此结项，产生的节余资金856.72元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益）已用于永久补充公司流动资金。公司在兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行开立的账号为499050100100419345的募集资金专户、在招商银行股份有限公司合肥分行开立的账号为551904996610555的募集资金专户均已办理销户手续，公司与中金公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

2023年6月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中金公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2024年12月31日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式累计支付了募投项目所需资金共计970,670,091.43元，以募集资金829,159,209.30元进行了等额置换，剩余141,510,882.13元待置换。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份的资金来源为公司超募资金、自有及自筹资金，2024 年 3 月 15 日该方案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（更正后）》（公告编号：2023-042）及《晶合集成 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。保荐机构中金公司对本事项出具了无异议的核查意见，详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 164,520,697.56 元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益）用于回购公司股份。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”、“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”达到预定可使用状态日期分别延期至 2024 年底、2025 年中。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年底。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。保荐机构中金公司对本事项出具了无异议的核查意见，详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议

案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	565,870,902.42	
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	96,264,270.22	
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	5,780,603.03	
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	0.00	2024年7月17日销户
兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	0.00	2024年7月19日销户
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	0.00	2024年5月17日销户
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	2,433,307.99	
合计		670,349,083.66	/

注：募集资金存放专项账户的存款余额不包含报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 750,000,000.00 元。

（二）募集资金合规情况

2024 年 12 月 18 日，公司误从中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行开立的募集资金存放专项账户支付了一笔非募集资金用途的零配件费用，金额为人民币 528,161.62 元。公司在进行 2024 年度募集资金存放及使用情况的梳理统计过程中发现该问题，于 2025 年 1 月 13 日及时将 528,161.62 元从自有资金账户归还至募集资金账户。上述错付行为未造成募集资金损失，未对公司募集资金投资项目进程产生不利影响。公司将继续加强募集资金使用的培训力度，保护募集资金安全。

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形，对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，晶合集成董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭兆志	董事	选举	换届选举
谢明霖	董事	选举	换届选举
蔺智挺	独立董事	选举	换届选举
郑素芬	董事	离任	换届离任
朱晓娟	董事	离任	换届离任
BEICHAO ZHANG（张北超）	独立董事	离任	换届离任
李迦渝	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
简瑞荣	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
李庆民	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
吴志楠	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
黎翠綾	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
张伟瑾	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
方华	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
郭圣忠	协理	离任	章程修订，协理不再认定为高级管理人员
詹奕鹏	副总经理	离任	换届离任
詹奕鹏	核心技术人员	离任	个人原因
郑志成	核心技术人员	聘任	公司经营管理需要
蔡辉嘉	总经理及核心技术人员	离任	因个人及家庭原因辞职

截至 2024 年 12 月 31 日，晶合集成现任及报告期内离任董事、监事、高级管理

人员和核心技术人员持有公司股份变动的情况如下：

姓名	职务	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年度内股份增 减变动量 (股)	增减变动原因
周义亮	副总经理	142,372	167,115	24,743	二级市场买卖
方华	协理	81,822	43,400	-38,422	二级市场买卖
合计	/	224,194	210,515	-13,679	/

注：以上持股均为直接持股，不含间接持股。

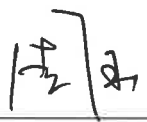
截至 2024 年 12 月 31 日，晶合集成的控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

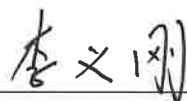
无。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



周 玉



李义刚

